

レスキューロボットコンテストに特別協賛

「技術を学び 人と語らい 災害に強い世の中をつくる」というレスキューロボットコンテストの理念に賛同し、CSR(企業の社会的責任)の一環として、特別協賛しております。

第14回 レスキューロボットコンテスト 杯 By 東京エレクトロン デバイス

競技会本選 2014年8月9～10日

会場 デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)

レスキューロボットコンテストは、大規模都市災害における救命救助活動を題材としたロボットコンテストです。神戸と東京の予選を通過した計14チームが集い、ロボットの性能・技術を競います。



第13回コンテスト競技会本選

<http://www.rescue-robot-contest.org/>

IR サイトのご紹介

当社のIRサイトは、投資家の皆様に事業内容や業績・財務の情報をわかりやすくご理解いただくために日々の更新と見直しを行っております。

日興アイ・アール(株)が選ぶ「2013年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」において「優秀サイト」に選定されました。

今後も迅速かつ公平な情報開示に努めてまいります。



<http://www.teldevice.co.jp/ir/>

将来の業績見通しに関する注意事項

このインベスターズガイドは、2014年7月1日時点で作成されています。ビジネス戦略、業績予想などの将来の見通しに関する事項は、その時点で入手可能な情報から当社の経営者の判断に基づいて書かれており、経営環境の変化により修正することがあります。したがって、当社は、内容の正確性、信頼性など、一切保証しませんので御了承下さい。最新情報については、公表資料または当社 Webサイトを御参照下さい。

お問い合わせ先



東京エレクトロン デバイス

広報・IR室 E-mail: ir-info@teldevice.co.jp

本社:〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4 横浜イーストスクエア
TEL:045-443-4000(代表) FAX:045-443-4050



適切に管理された森林からの原料を含む FSC® 認証紙と環境に配慮した植物油インキを使用しております。

株主・投資家の皆様へ

INVESTORS GUIDE 2014

インベスターズガイド



東京エレクトロン デバイス

株主・投資家の皆様へ

株主・投資家の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご支援を賜り、心より厚く御礼申し上げます。

当社は、半導体やIT機器等の技術商社として付加価値の高い商品を提供し
続けてまいりました。今後も既存事業の一層の発展と新分野への挑戦を活動方針
に、さらなる企業価値向上に努めてまいりますので、変わらぬご支援を賜りますよう
お願い申し上げます。



代表取締役社長
栗木 康幸



代表取締役副社長
久我 宣之

2014 年 3 月期の業績報告

2014年3月期におけるわが国経済は、日銀の施策等を背景に円安基調で為替が推移したことにより輸出環境は改善し、期末にかけて設備投資が持ち直すなど企業を取り巻く環境が好転する中、緩やかに回復いたしました。

このような状況のもと、2014年3月期の売上高は1,018億1百万円(前期比19.1%増)、売上構成比の変化等により営業利益は14億9千万円(同16.8%減)、為替差損の計上等により経常利益は10億3千9百万円(同19.6%減)、投資有価証券に係る評価損を計上したことなどにより当期純利益は3億8千8百万円(同41.1%減)となりました。

当社グループが参画しております業界の動向につきましては、半導体及び電子デバイス事業については、2013年は全世界における半導体製品の売上高が米国・アジア地域にけん引される形で過去最高を記録する中、海外ではスマートフォンや車載向け製品の需要が拡大しております。国内ではFA機器や医療機器等の産業機器が堅調に推移したことに加え、消費税率の引き上げを見据えた駆け込み需要等の影響もあり、期末にかけて急回復を示す形となりました。コンピュータシステム関連事業については、国内IT投資の成長率がほぼ横ばいで推移する中、クラウドコンピューティングの躍進に伴い、データセンター、関連の設備投資については堅調に推移しております。

各セグメントにおける業績の詳細につきましては、半導体及び電子デバイス事業は5ページ、コンピュータシステム関連事業は9ページにそれぞれ記載させていただいております。

2015 年 3 月期の見通しと中期経営計画

● 2015 年 3 月期の見通し

消費税率引き上げを見据えた駆け込み需要に対する反動減等により、一時的な景気の減速が懸念されるものの、その後は各種政策の効果が現れてくることで、緩やかな回復を見込んでおります。

半導体及び電子デバイス事業では自動車や産業機器等の分野を中心に、関連商材に対する需要拡大を見込んでおり、コンピュータシステム関連事業ではクラウドコンピューティングの普及に伴い、関連ビジネスが伸長するものと想定しております。

このような状況を踏まえ、2015年3月期の通期連結業績見通しについては、売上高1,100億円(前期比8.1%増)、経常利益17億円(同63.5%増)、当期純利益11億4千万円(同193.8%増)を見込んでおります。

● 中期経営計画

当社では、ローリング方式を採用した「中期経営計画」を策定しております。

2013年の内容を見直し、更新したものを2014年4月25日に以下の通り発表いたしました。



【事業方針】

半導体及び電子デバイス事業

価格競争や為替変動等の外部要因はあるものの、既存ビジネスの充実や商権獲得等による事業規模の拡大を目指し、今まで以上に迅速な対応が可能となる業務プロセスの見直しを含め、事業環境の変化にも柔軟に取組めるような機構改革を行ってまいります。

自社開発「inrevium (インレビウム)」製品に対する品質管理等の徹底に努め、利益面の改善に向けては2014年3月期に設立した北米の拠点活用やパートナーとの協業等により、インレビウムビジネスの伸長と拡充を目指してまいります。

〈新規事業〉

既存ビジネスの伸長・拡大に加え、インターネットを通じたサービスの提供や環境・省エネ関連事業など、新たな市場開拓にも注力してまいります。また、これまで培ってきたビジネスの経験をいかしつつ、事業上のリスクを把握・検討した上で今まで取扱いのなかった事業分野への参入も図ってまいります。

コンピュータシステム関連事業

データセンター等のクラウド利用に対する企業のIT投資の拡大が予想されることから、クラウド関連市場において競争力のある新商品・新商材を導入していくことによって顧客の多様なニーズに応えてまいります。また、保守ビジネスでは体制の強化を加速していくことで、サポートサービスの充実を図ってまいります。

東京エレクトロンデバイスは、 半導体とIT機器の技術商社です。

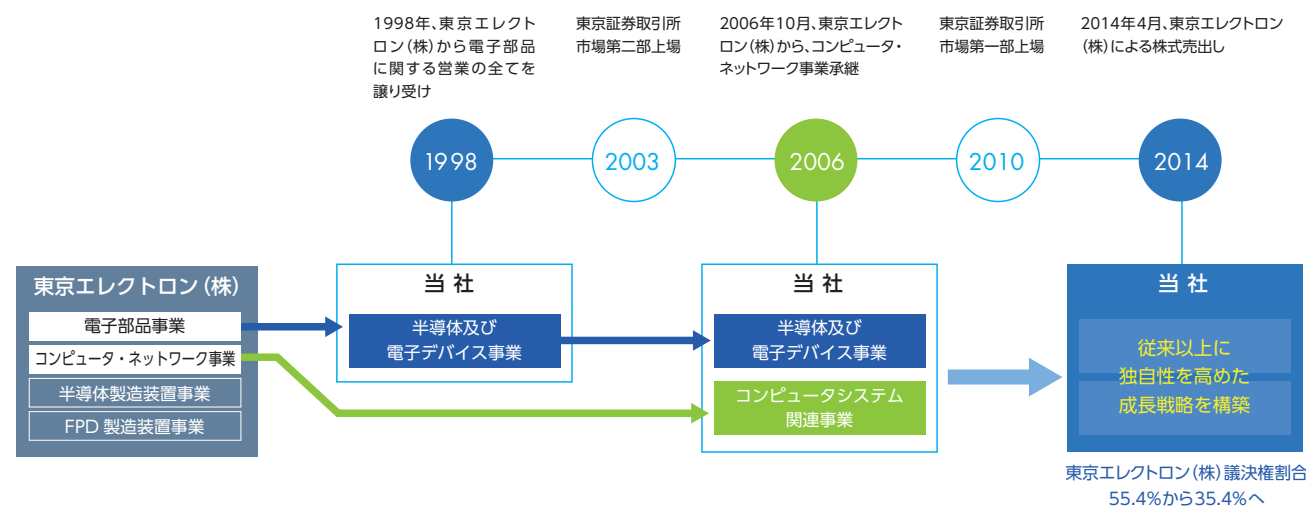
自己株式取得と株式売出し

●自己株式取得

2014年4月1日に東京エレクトロン株式会社が保有する当社普通株式 636,000 株を 859,872,000 円で取得いたしました。これは資本効率の向上を図るとともに将来の経営環境の変化に対応する機動的な資本政策の遂行を可能とするためです。

●株式売出し

2014年4月15日に東京エレクトロン株式会社による当社普通株式の売出しが行われ、売出し価格1,336円でオーバアロットメントを含む1,706,600株の売出しが完了いたしました。これにより、当社は東京エレクトロン株式会社の連結子会社から持分法適用関連会社となりました。従来以上に独自性を高めた成長戦略を構築することで、企業価値向上に努めてまいります。



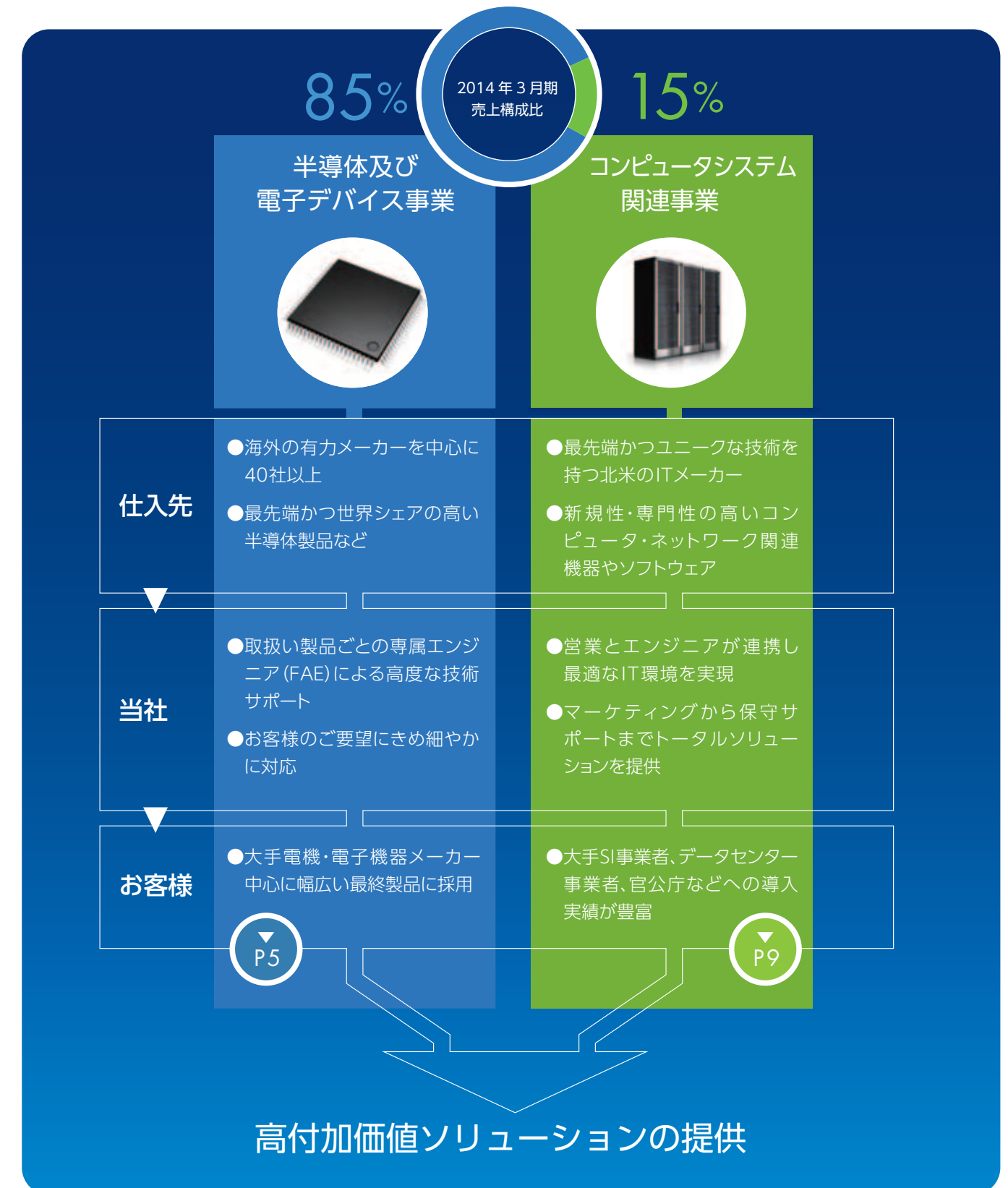
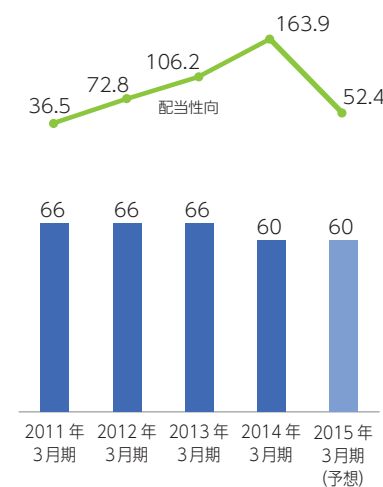
株主還元について

当社は、株主重視を経営の最重要事項の一つと位置付けており、継続的かつ安定的な配当実施を基本として、業績を反映した適正な利益還元を原則としております。当面の配当性向の水準については連結当期純利益の35%程度を目安といたします。

2014年3月期の配当につきましては、一株当たり中間配当3,000円(※分割調整後30円)、期末配当を30円とさせていただきます。2015年3月期の配当につきましては、業績予想に基づき検討した結果、一株当たり年間配当金60円(中間30円・期末30円)とさせていただきます予定です。

※当社普通株式の売買単位を100株とするため、2013年9月30日を基準日とし1株を100株に分割するとともに、2013年10月1日を効力発生日に100株を1単位とする単元株制度を採用いたしました。
※右グラフの一株当たり配当金は2013年10月1日の株式分割(1株→100株)を反映した金額にて記載しております。

一株当たり配当金(円)/配当性向(%)



半導体及び電子デバイス事業

2014 年 3 月期の業績

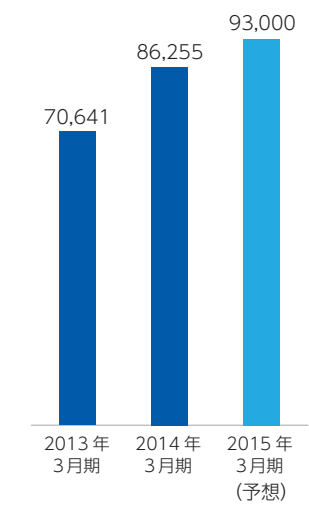
産業機器向けの部品需要の高まりや新規商材の立ち上がりに加え、中国及びアジア地域においてカーナビゲーションをはじめとした車載向けの部品需要が伸長し、汎用ICを中心に総じて堅調に推移いたしました。これらの結果、売上高は862億5千5百万円(前期比22.1%増)、セグメント利益(経常利益)は売上構成比の変化や為替差損の計上のほか、外貨建ての仕入値引債権の一部回収不能や自社開発製品の一部不具合に伴う損失を計上したことなどにより、9百万円(同94.1%減)となりました。

2015 年 3 月期の業績予想と事業方針

2015年3月期の業績は、売上高930億円(前期比7.8%増)を予想しており、以下の5項目の事業方針に注力してまいります。

- 取扱い製品の拡充
 - 海外ビジネスの拡大
 - 自社商品(インレビウム)の拡大
- 環境・省エネルギー分野への取組み
 - 新規商材開拓及び新商流構築

半導体及び電子デバイス事業 売上高(百万円)



仕入先は有力半導体メーカー

当社では、各分野において高いシェアを誇る世界トップクラスの半導体メーカーの製品を取扱っております。
2014年3月期は全品目で前期に比べ売上高が増加いたしました。特に汎用ICが商権の拡大を要因に40%増、メモリICが新商材(FRAM、SRAM)により44%増となりました。また、産業機器向けの需要拡大により、光学部品が19%増、カスタムICが12%増となりました。

品目別売上高構成比

2013 年 3 月期	2014 年 3 月期	主な商品		主な仕入先	仕入先紹介
27%	31%	汎用 IC 様々な用途に使用される IC	アナログ IC	TI 社 リニアテクノロジー社	 高性能アナログIC 専門メーカー
		専用 IC 特定用途向け IC	DLP 用 画像補正用 通信用	TI 社 ピクセルワークス社 サイプレス社	 DSP やアナログIC をはじめ 多種多様な製品を提供
19%	17%	カスタム IC お客様仕様に応じて作られる IC	PLD ASIC	ザイリンクス社 富士通セミコンダクター(株)	 PLD のリーディングカンパニー
17%	15%	マイクロプロセッサ コンピュータの頭脳となる IC	マイクロプロセッサ DSP	フリースケール社 TI 社 インテル社	 車載・通信用 IC で世界最大手
13%	12%	光学部品 電気を光に変換する電子部品	LED フォトカプラ	アバゴ・テクノロジー社	 ヒューレットパッカード社が前身の 光学部品パイオニアメーカー
7%	7%	メモリ IC 記憶用の IC	FRAM SRAM フラッシュメモリ	サイプレス社 IDT 社 スパンション社	 USB 技術のリーダーのメーカー 広範囲な製品群を提供
4%	5%	電子部品他 ボード製品、電源、ソフトウェアなど	OS 電源 評価ボード	マイクロソフト社 コーセル(株) インレビウム	 マイクロソフト社の組み込み機器向け OS
13%	13%				

サポート体制

● 高度な技術サポートを提供

取扱い製品ごとに専属のエンジニア(FAE)を配置しており、お客様(電機・電子機器メーカー)の製品開発の企画段階から量産まで、技術説明や設計サポート、不具合発生時には検証を行うなどの高度な技術サポートを提供しております。

また、お客様の開発エンジニア向けに開発ツールや設計手法などの技術セミナーを開催しており、スムーズに新規製品の設計作業ができるようサポート体制を整えております。



● 一貫したお客様サポート

お客様の開発拠点や生産拠点の近くに営業拠点を置くことで、製品のお問い合わせの対応や課題解決に向けたご提案、開発・量産に向けた調達など、タイムリーできめ細かいサポートを行っております。

幅広い用途向けに販売

お客様は大手電機・電子機器メーカーが中心でその最終製品は多岐にわたり、幅広い用途に満遍なく販売しております。
2014年3月期は、産業機器分野ではFA機器や医療機器向けの需要が国内で堅調に推移したことで用途別売上高構成比における売上シェアは35%、売上高は前期比23%増となりました。また、売上シェアが5%アップし、14%になった車載機器分野は、海外での需要が拡大したことで売上高は前期比83%増となりました。

用途別売上高構成比

2013 年 3 月期	2014 年 3 月期	主な最終商品		主なお客様
35%	35%	産業機器	 医療機器 半導体製造装置 ロボット 計測器	沖電気 東芝 パナソニック 日立
		コンピュータ・周辺機器	 複合プリンター PC 及び付属機器 プロジェクタ POS 端末	東芝 NEC パナソニック 富士ゼロックス
23%	22%	民生機器	 TV デジタルカメラ AV 機器 白物家電	アルプス電気 東芝 パナソニック 三菱電機
16%	15%	通信機器	 基地局 スマートフォン 伝送装置	NEC パナソニック 日立 富士通
17%	14%	車載機器	 カーナビゲーション カーオーディオ	アルプス電気 パナソニック 日立 三菱電機
9%	14%			

※主なお客様はグループ名で表記し、敬称を省略し、略称とさせていただきます。(五十音順)

海外ビジネスとインレビウムビジネスの強化

●海外ビジネス

日系企業の海外生産移転に伴い、海外物流業務(移管ビジネス)が一層増加しております。

このような状況の中、中国・アジア向けに販売を行う当社連結子会社 TED APACの2014年3月期の売上高は216億9千9百万円(前期比36.7%増)となり、半導体及び電子デバイス事業の売上高862億5千5百万円に対する売上高比率は25.2%に達しました。2015年3月期は、売上高280億円、売上高比率は30.1%を見込んでおります。

●インレビウムビジネス

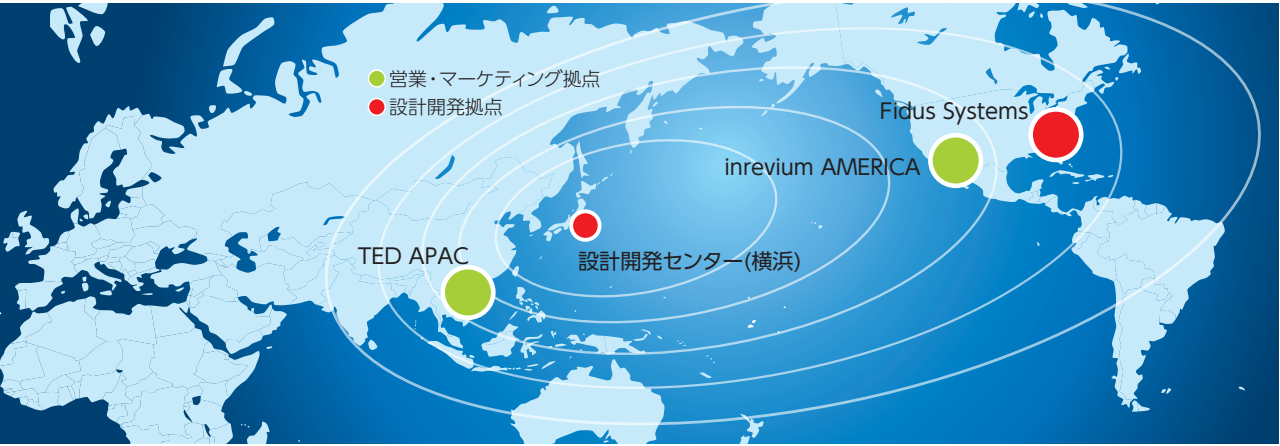
半導体商社ビジネスで培った技術力、マーケティング力をいかし、インレビウムビジネスとして半導体の企画・開発(自社ブランド商品)と設計受託(デザインサービス)を行っています。

自社ブランド商品の販売とデザインサービスを合わせたインレビウムビジネスの2014年3月期の売上高は27億6千4百万円(前期比0.2%減)となりました。2015年3月期は、売上高33億5千万円を見込んでおります。

●海外ビジネスとインレビウムビジネスのシナジー効果

海外ビジネス、インレビウムビジネス共に、これまで注力してきた日本・アジア地域に加え北米エリアでの活動を推進してまいります。

その取組みとして、日系お客様の移管ビジネスや設計開発案件、現地メーカーへの自社ブランド商品販売を目的として2014年1月にインレビウムアメリカを設立いたしました。2014年3月にはデザインサービスとコンサルティングを提供するFidus Systems, Inc. (ファイダス システムズ、以下ファイダス社)と資本提携を行い、インレビウムアメリカと協業することで北米地域のお客様にデザインサービスを提供できる体制を築きました。また、当社の設計開発センターとファイダス社が協業することで両社の専門分野を補完し合い、幅広いデザインサービスと次世代自社製品の開発が可能になります。



カバーエリアの拡大

TED APAC
TOKYO ELECTRON DEVICE ASIA PACIFIC LIMITED
中国及びアジアパシフィック地域での販売活動



inrevium
inrevium AMERICA, INC.
アメリカを中心とした北米地域での販売活動

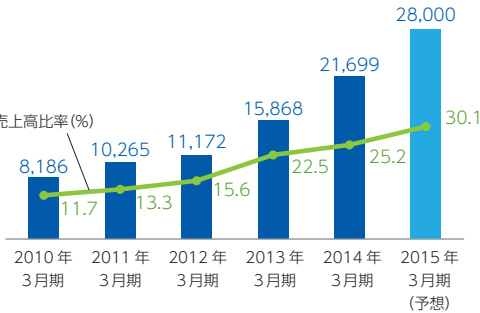
技術力の強化

inrevium
画像機器、放送機器、医療機器など、幅広いアプリケーションで実績

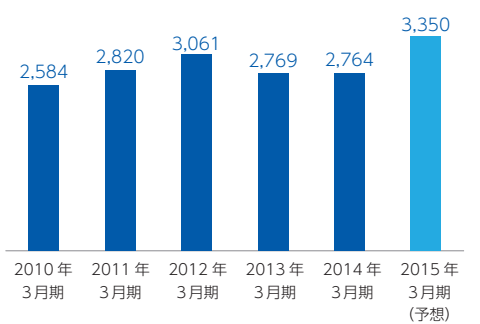


fidus
Electronic Product Development
高速かつ複雑な大容量FPGAの設計開発に強み

海外連結子会社売上高 (百万円)



インレビウムビジネス売上高 (百万円)



トピックス

●車載ビジネス

自動車産業では車の電子化やIT化に伴い半導体の需要がますます高まっており、当社も車載ビジネスは重点分野と考えております。

安全性・信頼性で高い基準を有する業界であるため、搭載する半導体の品質管理や技術サポートも非常に重要です。

当社では自動車メーカーのお客様の開発がスムーズに進むよう、半導体メーカーとも密に連携して継続的なサポートを行っております。

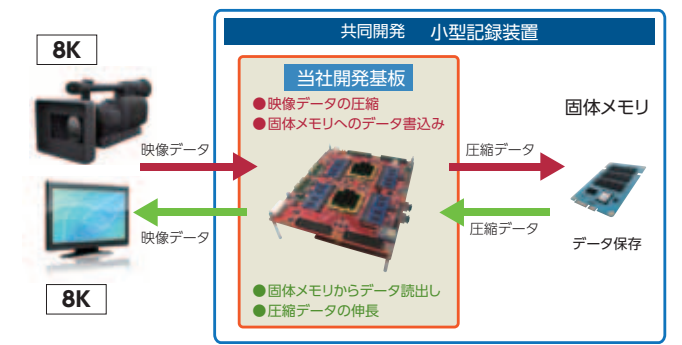


●開発例：スーパーハイビジョン8Kカメラ用小型記録装置

8Kスーパーハイビジョンは、現行のハイビジョンの16倍に当たる高精細画像と22.2ch音声による次世代テレビのための超高臨場感システムです。

8Kスーパーハイビジョンはカメラで撮影した映像データが膨大になるので、記録するには高画質を維持しながら圧縮・伸長する技術や、高速で記録装置に読書きする技術が重要なポイントとなります。

当社はこの最先端技術の分野において、NHK放送技術研究所様と共同開発を続けてまいります。



〈新規事業〉

事業領域拡大のため、新たな市場開拓に力を入れており、現在は環境関連やIoT*など成長が見込める分野に焦点を当てた活動を行っています。環境関連においては、資源価格の高騰により省エネルギー化への関心が高まる中、生産設備への投資需要が見込めるアジア地域に最適な商材の開拓と販売に注力しております。今後大きな成長が見込めるIoTにおいては、当社の技術やノウハウを集約してIoT時代に活躍する自社ブランド製品の開発にも取り組んでまいります。

1 環境関連の商材を世界中に販売

「省エネマルチコントローラ」

- 空調冷凍設備の省エネ管理装置
- 省エネ化への関心が高いアジア市場向けに販売活動中

工場

空調管理

工場設備の劣化を監視 無線で状況を伝達

2 IoTの製品を開発

「ワイヤレスセンサネットワーク向け評価ボード」

- 複数台のセンサを無線で繋ぎ、状況を伝達する監視システム製品
- 工場などの設備劣化状態や電力使用状況などの監視が可能

※IoT (Internet of Things) とは?
パソコンなどのコンピュータ端末だけでなく、あらゆる“モノ”がインターネットに繋がる仕組みです

※図はイメージです

コンピュータシステム関連事業

2014 年 3 月期の業績

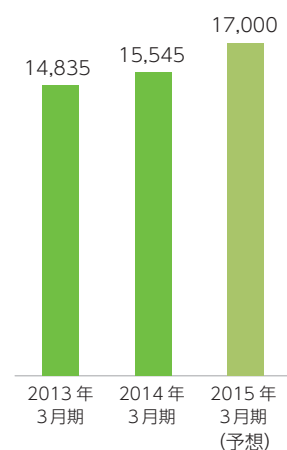
クラウド関連向けに新規導入した商材が寄与する形で製品販売が堅調に推移したことなどから、売上高は155億4千5百万円(前期比4.8%増)、セグメント利益(経常利益)は保守ビジネスの利益率が総じて低下傾向にあることから10億3千万円(同9.5%減)となりました。

2015 年 3 月期の業績予想と事業方針

2015 年 3 月期の業績は、売上高 170 億円(前期比 8.6% 増)を予想しており、以下の3 項目の事業方針に注力してまいります。

- 取扱い製品の拡充
- トータルソリューション提供への取組み
- データサービス等の新事業領域への参入

コンピュータシステム関連事業 売上高(百万円)



専門性の高い商品を中心にラインアップ

当社は、新規性と専門性の高いネットワーク関連機器やストレージ関連機器を取扱っております。

2014年3月期は、データセンター事業者向けに好調だったストレージ関連機器の売上高が前期に比べ12.5%増となり、ソフトウェアも14.3%増と好調でしたが、ネットワーク関連機器の売上高は、製品販売は堅調だったものの保守ビジネスの減少により1.1%減となりました。

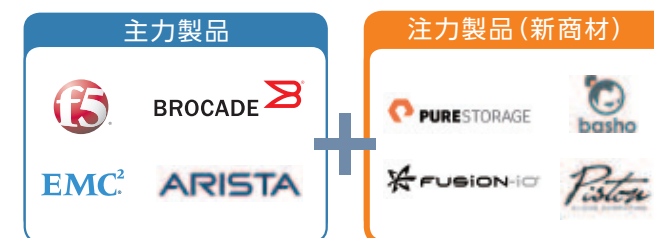
品目別売上高構成比

2013 年 3 月期	2014 年 3 月期	主な商品		主な仕入先	仕入先紹介
58%	55%	①ネットワーク関連機器 インターネットの接続負荷の分散 セキュリティ強化	負荷分散機器 ファイアウォール LANスイッチ	F5ネットワークス社 ジュニパー・ ネットワークス社 アリスタ・ ネットワークス社	 1 台で数万規模の同時アクセスを 可能にする負荷分散装置メーカー
33%	36%	②ストレージ関連機器 大容量データの記憶、統合技術に よるコスト削減	SANスイッチ ストレージ全般 フラッシュストレージ	ブロード社 EMC社 フュージョン・アイオー社 ピュアストレージ社	 外部記憶装置のデータ処理を 最適化する SAN スイッチメーカー
9%	9%	③ソフトウェア他 データベース管理、 クラウドマネジメントシステム	データベース 仮想化ソフトウェア	オラクル社 パシオー・テクノロジー社	 データベース管理ソフトで 世界シェアトップ

クラウド分野の新商材をデータセンター事業者向けに販売

クラウド関連へのIT投資は増加傾向にあり、今後も成長が見込まれております。

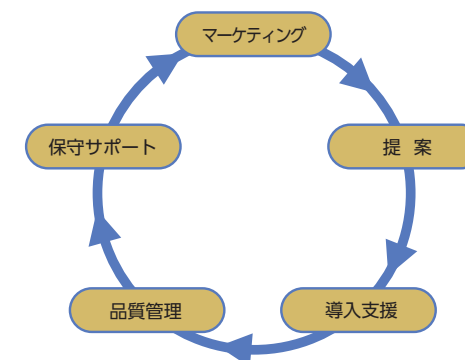
こうした市場環境を踏まえ、当社ではクラウド分野で優位性のある新商材の開拓と販売に力を入れております。注力製品である新商材と主力製品を組み合わせ、クラウドへのニーズが高いデータセンター事業者などへの販売活動に注力しております。



マーケティングから保守サポートまでをトータルソリューションとして提供

当社では、最先端かつユニークなIT製品を日本市場にいち早く投入するため、アメリカのシリコンバレーにマーケティング拠点を置いております。発掘した新商材は専門性の高い営業とエンジニアが連携してお客様へのご提案と導入支援を行っております。

また、品質管理や導入後の保守サポートまで行うことで、最新のIT製品の導入に関するサービスをトータルで提供する体制を整えております。



データサービス領域へ参入 ～日本最大級の献立提案アプリ Ohganic ～

Ohganic (オーガニック)は、カロリー、調理時間、アレルギー食材、予防したい病気などを設定すると条件に合った栄養バランスの良い献立を提案する無料アプリです。2014年3月期は、Android版の提供を開始し、献立数を300万件に拡充して、病気予防などの条件項目を充実させる機能の拡張を行い、2014年7月には登録者数が5万人を超えました。

Ohganicには、データ処理エンジンとサービス運用管理システムの上で動作する技術を採用しており、この技術をいかしてデータサービス領域に参入し、企業向け(BtoB)ビジネスとして展開してまいります。

誰でも簡単♪ 健康献立提案アプリ Ohganic

目的・条件を設定

- ☑ 600kcal 以下
- ☑ 調理時間 30 分以内
- ☑ にんじん嫌い
- ☑ 卵アレルギー
- ☑ 糖尿病予防

提案

条件に合う献立を提案

栄養バランスを確認できる

この献立の栄養バランス
あなたの日々の健康をサポート

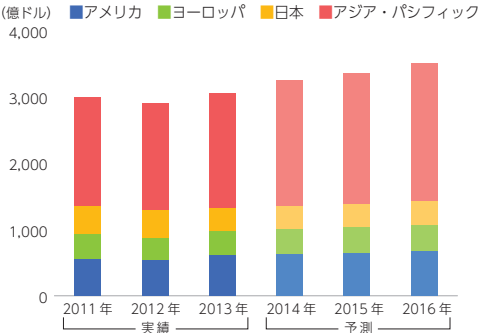
食物繊維
鉄分
炭水化物
タンパク質
糖質
カルシウム

半導体及び電子デバイス事業

世界の半導体市場予測

2013年の世界半導体市場は、製品ごとに多少の差はあったものの、半導体合計で見ると、ドルベースで前年比4.8%増と堅調な成長で市場規模は3,056億ドル(約29兆8,250億円)、対前年約140億ドル増となりました。2014年は、景気の緩やかな回復が継続するとともに電子機器市場の安定成長が見込まれ、6.5%増と予測されています。2015年は3.3%増、2016年は4.3%増と緩やかな成長が継続し、2013年から2016年までの年平均成長率は4.7%、2016年には市場規模3,505億ドルになるものと予測されています。

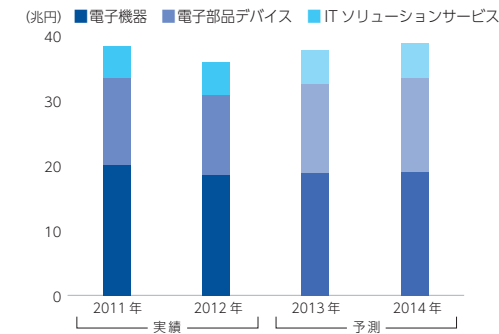
出所：WSTS「2014年 春季半導体市場予測」



電子情報産業における日系企業の世界生産見通し

電子情報産業における2013年の日系企業生産額(海外生産分を含む)は、37兆7,059億円(対前年5%増)と2年連続のマイナスを脱し3年ぶりのプラス成長となりました。2014年は個人モバイル端末や自動車市場の成長を取り込んだ電子部品・デバイスの成長とITソリューション・サービスの堅調な伸長を想定し、38兆7,864億円(同3%増)のプラス成長の見通しです。

出所：JEITA「電子情報産業の世界生産見通し」



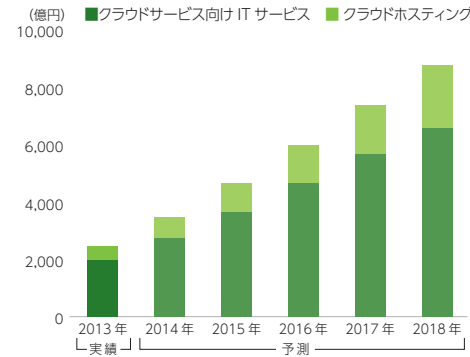
※電子機器=AV機器、通信機器、コンピュータ及び情報端末、その他

コンピュータシステム関連事業

国内クラウドサービス向けITサービス市場予測を発表

2013年の国内クラウドサービス向けITサービス市場規模は、2,024億円(前年比37.8%増)となり、2018年の市場規模は6,636億円になるものと予測されています。この市場は、ベンダーの知識や知見に基づき人的能力を提供する「クラウドサービス向けITサービス」とIaaSやホスティング型プライベートクラウドなどの「クラウドホスティング」を合算した市場と定義されています。日本経済の成長、金融機関や官公庁における大型投資案件など、国内ITサービス市場は堅調に推移していますが、既存システム領域に対する投資は抑制傾向が強く、ITの効率化を促進するクラウドの影響が強まっています。

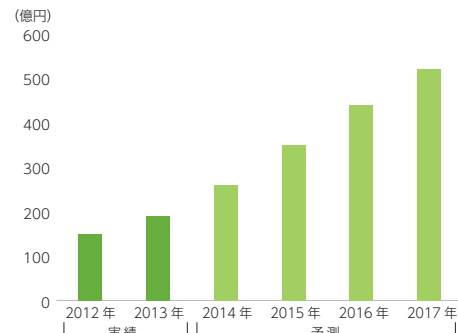
出所：IDC Japan ニュースリリース2014年6月23日
「国内クラウドサービス向けITサービス市場予測を発表」



国内クラウド向けストレージ市場予測

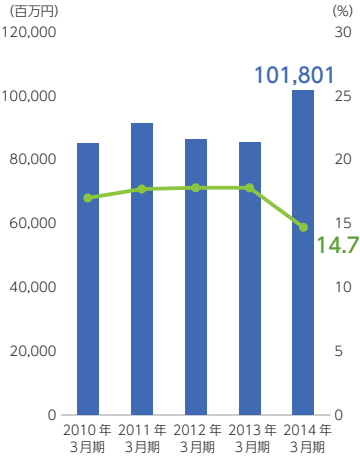
2013年はパブリッククラウド、プライベートクラウドともストレージインフラに対する投資が本格化してきたことで、国内クラウド向けストレージが高成長を遂げ、国内クラウド向けストレージの支出額は、194億900万円(前年比35.6%増)になる見込みです。また、2012~2017年における年間平均成長率は支出額で29.7%、2017年には支出額が524億7,800万円に達するものと予測されています。

出所：IDC Japan ニュースリリース2014年3月25日
「国内クラウド向けストレージ市場予測を発表」

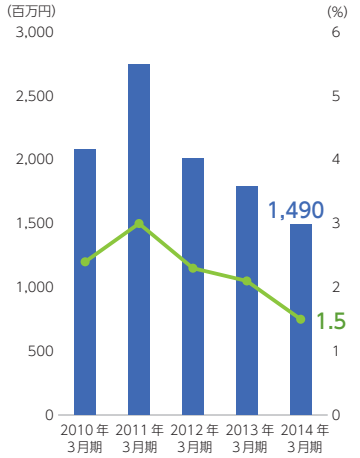


収益性

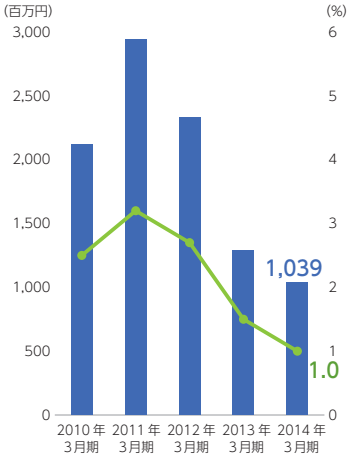
売上高 / 売上総利益率



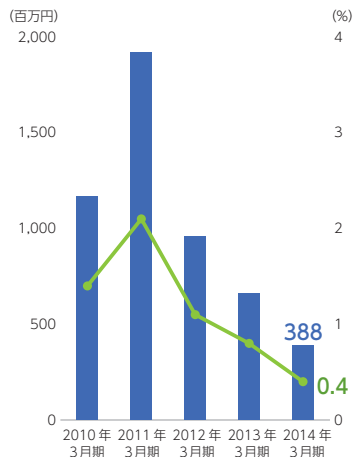
営業利益 / 営業利益率



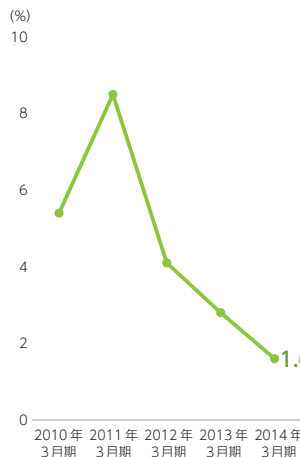
経常利益 / 経常利益率



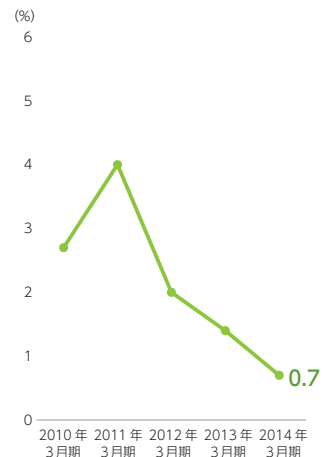
当期純利益 / 当期純利益率



自己資本当期純利益率(ROE)



総資産当期純利益率(ROA)



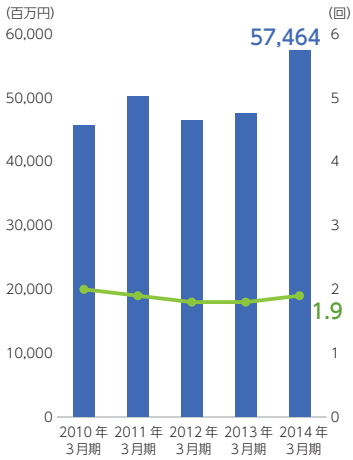
	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期
売上高(百万円)	85,145	91,315	86,300	85,477	101,801
売上総利益率(%) *1	17.0	17.7	17.8	17.8	14.7
営業利益(百万円)	2,079	2,745	2,011	1,790	1,490
営業利益率(%) *2	2.4	3.0	2.3	2.1	1.5
経常利益(百万円)	2,117	2,941	2,332	1,292	1,039
経常利益率(%) *3	2.5	3.2	2.7	1.5	1.0
当期純利益(百万円)	1,166	1,918	960	658	388
当期純利益率(%) *4	1.4	2.1	1.1	0.8	0.4
自己資本当期純利益率(ROE: %) *5	5.4	8.5	4.1	2.8	1.6
総資産当期純利益率(ROA: %) *6	2.7	4.0	2.0	1.4	0.7

*1. 売上総利益率=売上総利益÷売上高
*2. 営業利益率=営業利益÷売上高
*3. 経常利益率=経常利益÷売上高

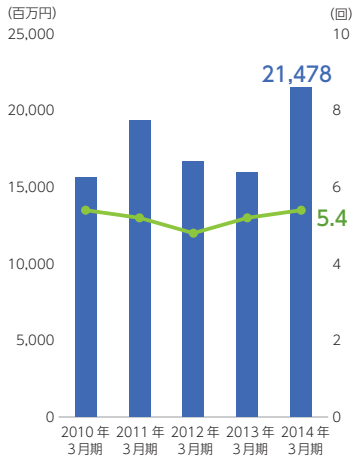
*4. 当期純利益率=当期純利益÷売上高
*5. 自己資本当期純利益率(ROE)=当期純利益÷期首・期末平均株主資本
*6. 総資産当期純利益率(ROA)=当期純利益÷期首・期末平均総資産

効率性・安全性

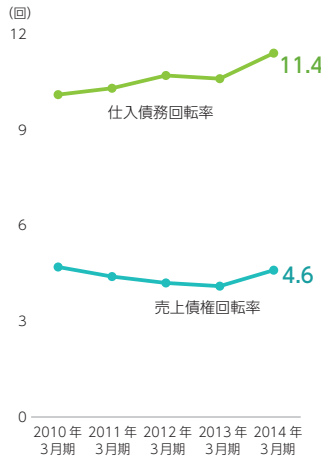
総資産 / 総資産回転率



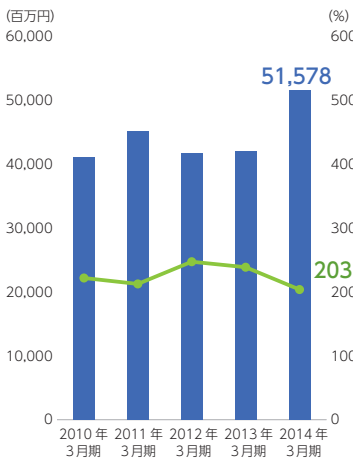
たな卸資産 / たな卸資産回転率



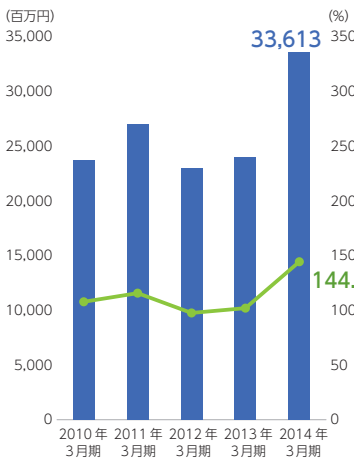
売上債権回転率 / 仕入債務回転率



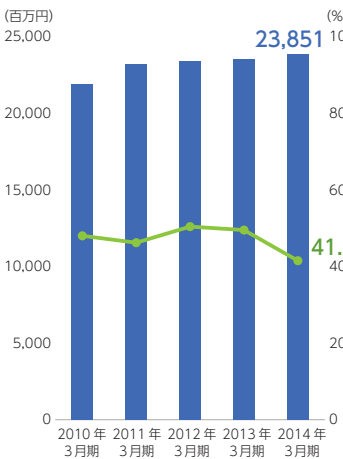
流動資産 / 流動比率



負債総額 / 負債比率

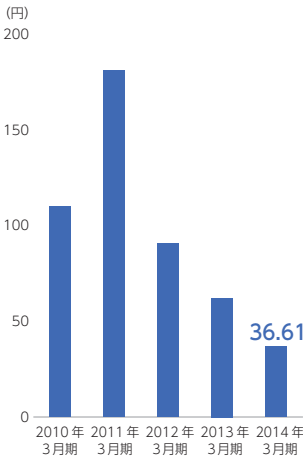


純資産 / 自己資本比率

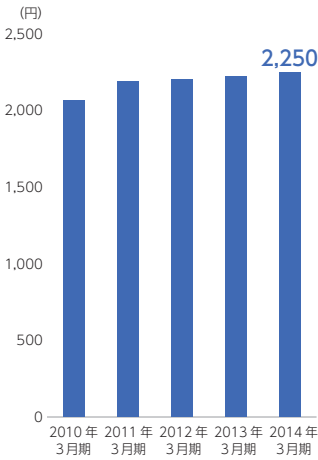


その他の指標

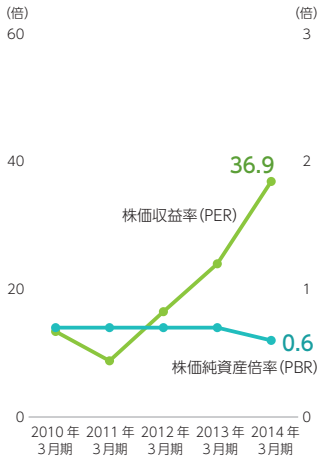
一株当たり当期純利益 (分割調整後) ※



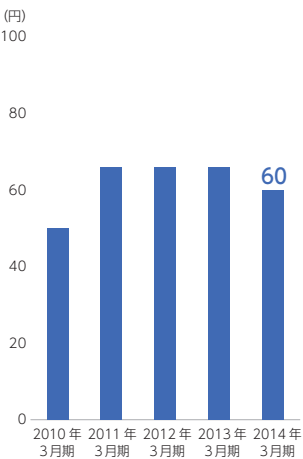
一株当たり純資産 (分割調整後) ※



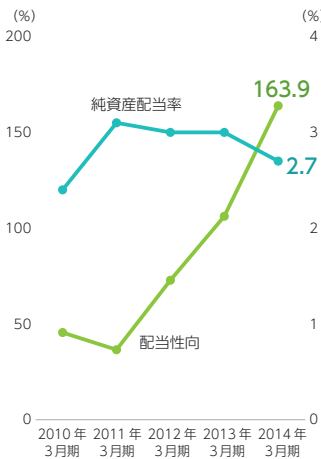
株価収益率 (PER) / 株価純資産倍率 (PBR)



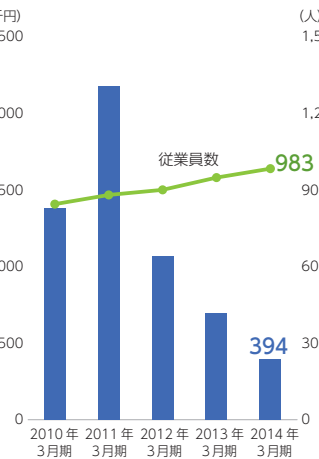
一株当たり配当金 (分割調整後) ※



配当性向 / 純資産配当率



従業員一人当たり当期純利益 / 従業員数



※上記の一株当たり指標のグラフは2013年10月1日の株式分割(1株→100株)を反映した金額にて記載しております。

	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期
総資産(百万円)	45,649	50,254	46,391	47,557	57,464
総資産回転率(回) *1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.9
たな卸資産(百万円)	15,636	19,347	16,681	15,983	21,478
たな卸資産回転率(回) *2	5.4	5.2	4.8	5.2	5.4
売上債権回転率(回) *3	4.7	4.4	4.2	4.1	4.6
仕入債務回転率(回) *4	10.1	10.3	10.7	10.6	11.4
流動資産(百万円)	41,136	45,251	41,770	42,082	51,578
流動比率(%) *5	221.9	212.6	247.4	238.8	203.8
負債総額(百万円)	23,737	27,034	23,009	24,012	33,613
負債比率(%) *6	107.7	115.6	97.5	101.9	144.3
純資産(百万円)	21,911	23,220	23,381	23,544	23,851
自己資本比率(%) *7	48.0	46.2	50.4	49.5	41.5

*1. 総資産回転率=売上高÷期首・期末平均総資産

*2. たな卸資産回転率=売上高÷期首・期末平均たな卸資産

*3. 売上債権回転率=売上高÷期首・期末平均(受取手形+売掛金)

*4. 仕入債務回転率=売上原価÷期首・期末平均買掛金

*5. 流動比率=流動資産÷流動負債

*6. 負債比率=負債÷株主資本

*7. 自己資本比率=純資産÷総資産

	2010年3月期	2011年3月期	2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期
一株当たり当期純利益 (EPS:円) *1	11,000	18,095	9,064	6,213	36.61
一株当たり純資産 (円) *2	206,711	219,063	220,584	222,118	2,250
株価収益率 (PER:倍) *3	13.4	8.8	16.5	24.0	36.9
株価純資産倍率 (PBR:倍) *4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
一株当たり配当金 (円) *5	5,000	6,600	6,600	6,600	60
発行済株式数 (千株)	106	106	106	106	10,600
配当性向 (%) *6	45.5	36.5	72.8	106.2	2.7
純資産配当率 (%) *7	2.4	3.1	3.0	3.0	163.9
従業員一人当たり当期純利益 (千円) *8	1,381	2,179	1,067	694	394
従業員数 (人)	844	880	900	948	983

*1. 一株当たり当期純利益 (EPS)=当期純利益÷期中平均発行済株式数

*2. 一株当たり純資産=期末純資産÷期末発行済株式数

*3. 株価収益率 (PER)=期末株価÷一株当たり当期純利益

*4. 株価純資産倍率 (PBR)=期末株価÷一株当たり純資産

*5. 一株当たり配当金=支払済中間配当及び期末配当÷発行済株式数

*6. 配当性向=支払済中間配当及び期末配当÷当期純利益

*7. 純資産配当率=配当金総額÷期首・期末平均純資産

*8. 従業員一人当たり当期純利益=当期純利益÷期末従業員数

連結貸借対照表

(単位：百万円)		
科 目	2013年3月期 (2013年3月31日現在)	2014年3月期 (2014年3月31日現在)
資産の部		
流動資産	42,082	51,578
現金及び預金	1,141	1,285
受取手形及び売掛金	21,099	22,994
商品及び製品	15,897	21,449
仕掛品	86	28
繰延税金資産	613	456
その他	3,382	5,364
貸倒引当金	△ 137	△ 2
固定資産	5,474	5,886
有形固定資産	1,131	989
建物及び構築物(純額)	832	737
工具器具備品(純額)	251	247
リース資産(純額)	6	2
建設仮勘定	40	1
無形固定資産	988	1,349
のれん	411	308
その他	577	1,041
投資その他の資産	3,354	3,547
退職給付に係る資産	—	829
繰延税金資産	2,010	1,810
その他	1,354	917
貸倒引当金	△ 10	△ 10
① 資産合計	47,557	57,464

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

① 資産

総資産は 574 億6千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ 99 億7百万円の増加となりました。これは主に、受取手形及び売掛金、商品及び製品が増加したことによります。

(単位：百万円)		
科 目	2013年3月期 (2013年3月31日現在)	2014年3月期 (2014年3月31日現在)
負債の部		
流動負債	17,622	25,310
買掛金	7,325	7,887
短期借入金	3,756	11,531
未払法人税等	486	238
前受金	3,352	3,592
賞与引当金	679	377
役員賞与引当金	24	7
その他	1,997	1,676
固定負債	6,390	8,302
長期借入金	—	2,000
退職給付引当金	5,746	—
役員退職慰労引当金	163	165
退職給付に係る負債	—	5,649
その他	480	487
② 負債合計	24,012	33,613
純資産の部		
株主資本	23,567	23,288
資本金	2,495	2,495
資本剰余金	5,645	5,645
利益剰余金	15,426	15,147
その他の包括利益累計額	△ 23	563
その他有価証券評価差額金	28	△ 0
繰延ヘッジ損益	△ 53	△ 16
為替換算調整勘定	1	105
退職給付に係る調整累計額	—	475
③ 純資産合計	23,544	23,851
負債・純資産合計	47,557	57,464

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

② 負債

負債総額は 336 億1千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ 96 億1百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金及び長期借入金が増加したことによります。

③ 純資産

純資産総額は 238 億5千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億6百万円の増加となりました。

連結損益計算書

(単位：百万円)		
科 目	2013年3月期 2012年4月1日から 2013年3月31日まで	2014年3月期 2013年4月1日から 2014年3月31日まで
売上高	85,477	101,801
売上原価	70,236	86,865
売上総利益	15,241	14,935
販売費及び一般管理費	13,450	13,444
営業利益	1,790	1,490
営業外収益	52	75
受取配当金	—	12
受取保険金	—	14
保険配当金	13	32
その他	39	15
営業外費用	550	526
為替差損	486	445
その他	63	81
経常利益	1,292	1,039
特別損失	9	317
固定資産除却損	8	9
投資有価証券評価損	—	307
その他	0	—
税金等調整前当期純利益	1,283	722
法人税、住民税及び事業税	628	248
法人税等調整額	△ 3	85
法人税等合計	624	334
少数株主損益調整前当期純利益	658	388
当期純利益	658	388

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結包括利益計算書

(単位：百万円)		
科 目	2013年3月期 2012年4月1日から 2013年3月31日まで	2014年3月期 2013年4月1日から 2014年3月31日まで
少数株主損益調整前当期純利益	658	388
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	28	△ 29
繰延ヘッジ損益	42	37
為替換算調整勘定	132	103
その他の包括利益合計	203	111
包括利益	862	499
▼内訳		
親会社株主に係る包括利益	862	499
少数株主に係る包括利益	—	—

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結キャッシュ・フロー計算

(単位：百万円)		
科 目	2013年3月期 2012年4月1日から 2013年3月31日まで	2014年3月期 2013年4月1日から 2014年3月31日まで
④ 営業活動によるキャッシュ・フロー	3,375	△ 7,664
⑤ 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,919	△ 1,086
⑥ 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,587	8,879
現金及び現金同等物に係る換算差額	7	16
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 123	144
現金及び現金同等物の期首残高	1,264	1,141
現金及び現金同等物の期末残高	1,141	1,285

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

④ 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果、使用した資金は76億6千4百万円(前年同期は33億7千5百万円の収入)となりました。これは主に、たな卸資産の増加及び売上債権の増加の資金減少要因によるものです。

⑤ 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果、使用した資金は10億8千6百万円(前年同期は19億1千9百万円の使用)となりました。これは主に、ソフトウェアの取得及び関係会社株式の取得の支払いによるものです。

⑥ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果、得られた資金は88億7千9百万円(前年同期は15億8千7百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金及び長期借入金の増加によるものです。

会社概要

(2014 年 3 月 31 日現在)

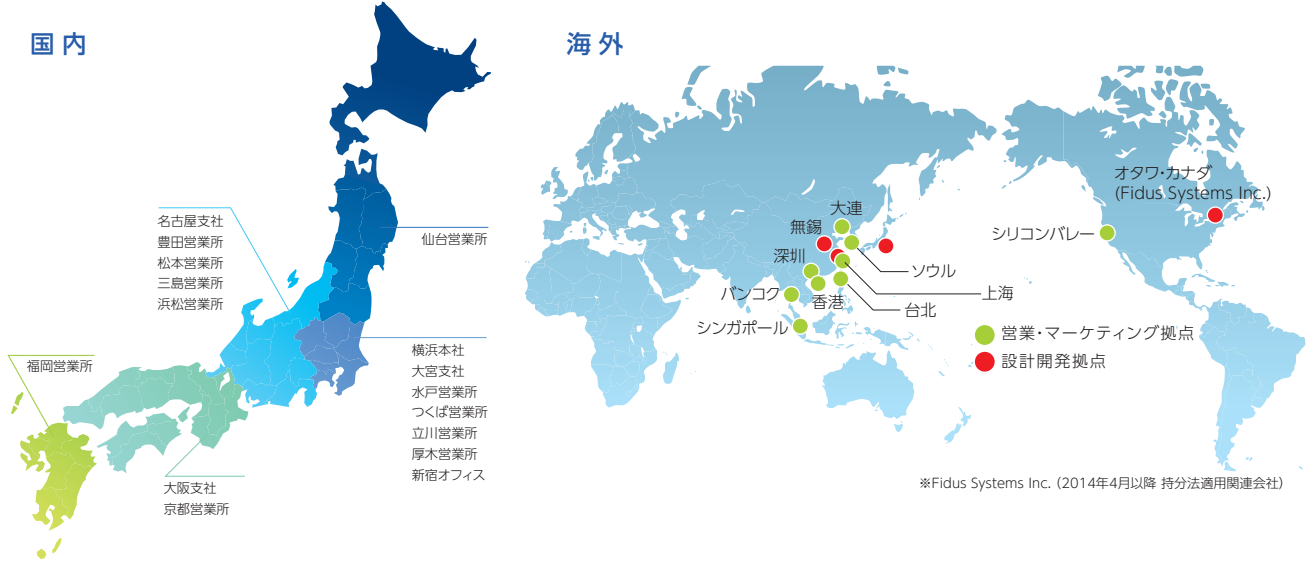
商 号	東京エレクトロン デバイス株式会社
設 立	1986 年 3 月 3 日
資本金	2,495,750,000 円
従業員数	983 名(連結)
本 社	神奈川県横浜市神奈川区金港町 1 番地 4 横浜イーストスクエア
グループ会社	パネトロン株式会社 東電電子零件亞太區有限公司(TED APAC) 上海華桑電子零件貿易有限公司(TED 上海) Tokyo Electron Device Singapore Pte. Ltd. inrevium AMERICA, INC. 上海華桑電子有限公司(インレビウム上海) 無錫華桑電子科技有限公司(インレビウム無錫)



本社外観

拠点

(2014 年 7 月 1 日現在)



役員等

(2014 年 6 月 18 日現在)

取締役

取締役会長	砂川 俊昭
代表取締役社長	栗木 康幸
代表取締役副社長	久我 宣之
取締役	天野 勝之
取締役	徳重 敦之
取締役	初見 泰男
取締役	上小川 昭浩
取締役(非常勤)	常石 哲男
社外取締役	石川 國雄
社外取締役	不破 久温

監査役

常勤監査役	武井 弘
常勤監査役	中村 隆
社外監査役	林田 謙一郎
社外監査役	福森 久美

執行役員

栗木 康幸
久我 宣之
天野 勝之
徳重 敦之
初見 泰男
上小川 昭浩
林 英樹
浅野 升徳
上善 良直
長谷川 雅巳

株式情報

(2014 年 3 月 31 日現在)

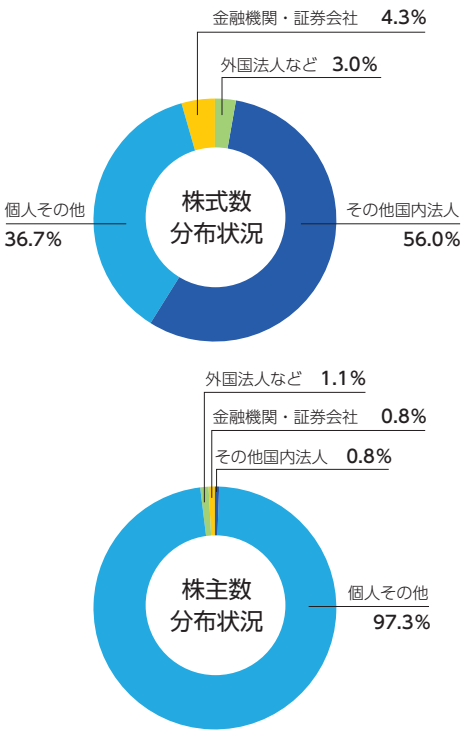
株式の状況

証券コード	2760
発行可能株式総数	25,600,000 株
発行済株式の総数	10,600,000 株
株主数	5,303 名
単元株式数	100 株

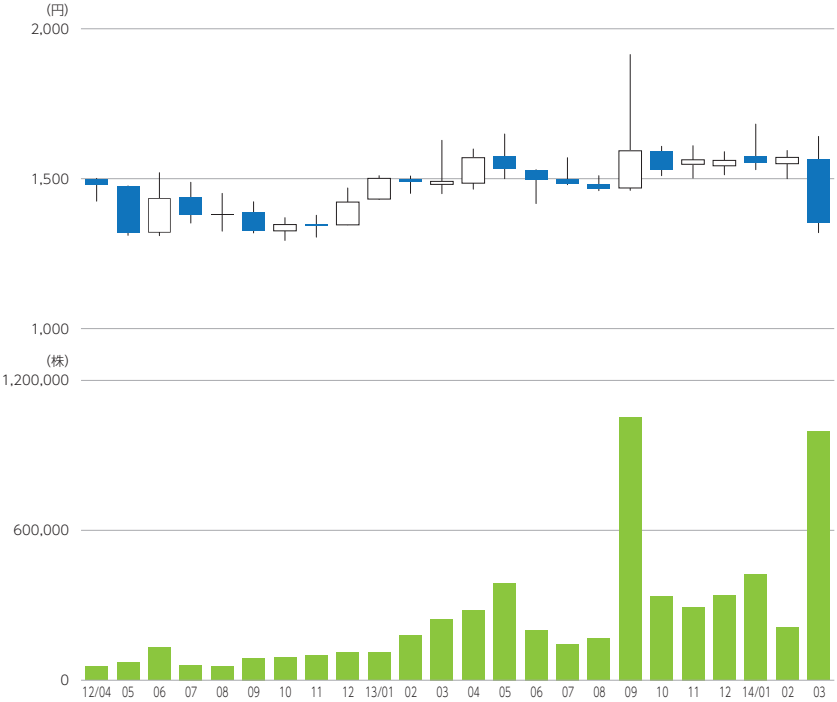
大株主の状況

株主名	持株数(株)	出資比率(%)
東京エレクトロン株式会社	5,875,300	55.4
東京エレクトロンデバイス社員持株会	487,579	4.6
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	87,800	0.8
JPMCB:CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE-JPY	49,000	0.5
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL	45,000	0.4

株式分布状況



株価と出来高



コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、株主各位及びステークスホルダーに対し一層の経営の透明性を高めるため、公正な経営を実現することを最優先に考えております。その一環として、新たに社外取締役を複数名選任し、外部の客観的な視点を経営に反映する体制といたしました。

当社の内部統制システムは、内部統制システム全体の整備と運用を推進する内部統制委員会のもと、倫理委員会がコンプライアンス体制を、リスク管理委員会がリスク管理体制を、情報セキュリティ委員会が情報の保存及び管理体制を推進しております。

なお、監査役会は、取締役会に対し、内部統制に関する提言を行い、内部統制委員会の監視も行っております。

内部統制システム

